

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	特定对象调研、路演活动：中信资管、西部利得基金、中银基金、太平养老、大家资产、展博投资、博时基金、财通基金、国泰君安资管、全天候基金、瀚川投资。	
时间	2025年9月15日至9月30日	
地点	特定对象调研、路演活动：公司会议室、腾讯会议、策略会现场等。	
上市公司接待人员姓名	特定对象调研、路演活动：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生。	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍主要内容</p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。</p> <p>公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼</p>	

容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

二、公司 2025 年上半年经营情况介绍

2025 年上半年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。公司 2025 年上半年实现营业收入 3.07 亿元，较上年同期增长 67.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,600.55 万元，较上年同期增长 91.56%；2025 年上半年，公司实现剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润 8,347.62 万元，较上年同期增长 108.10%；截至 2025 年 6 月末，公司总资产为 17.90 亿元，较上年末增长 11.96%；截至 2025 年 6 月末，公司净资产为 14.18 亿元，较上年末增长 7.77%。

产品方面，2025 年上半年，公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。2025 年上半年，EXCEED-9000 系列产品（EXCEED-9800 系列、EXCEED-9032 系列）设备销售收入比重进一步提升至 51.37%，2024 年为 25.80%。

公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能力，深化客户服务。2025 年上半年，公司积极拓展新增客户群体，持续深化既有客户合作关系，全面强化客户服务能力建设。2025 年上半年，公司“马来西亚生产运营中心”启用，助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。

三、调研问答

1、问：今年上半年业绩增长有哪些原因导致呢？

答：2025年上半年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。公司2025年上半年实现营业收入3.07亿元，较上年同期增长67.86%；实现归属于上市公司股东的净利润7,600.55万元，较上年同期增长91.56%。

2、问：公司产品未来升级迭代的方向？

答：公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势，公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。公司适用于MEMS的测试分选平台、适用于碳化硅及IGBT的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于Memory的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

3、问：请问公司人员方面较以前年度是否有变化？

答：公司员工总数无较大变化。目前公司管理体系仍相对灵活，未来将结合生产经营、研发进展、客户端需求等实际情况进行人员规划。

4、问：公司在供应链安全方面有什么策略？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司生产所需主要原材料主要为国内供应商、代理商或贸易商提供，其中部分涉及进口品牌，但主要生产地在中国大陆，同时，上述原材料能找到提供同类产品的国产厂商进行替代。

5、请问公司更新下对外投资的近况？

答：公司在继续加大技术开发和自主创新力度的同时，也通过对外投资方式积极布局重点关注的技术方向，截至目前公司已参股投资了5家公司：

	<p>(1) 半导体晶圆级分选封测和平板级封装贴晶机设备及方案提供商——深圳市华芯智能装备有限公司，公司主要产品为晶圆级分选机 Wafer to tape&reel（晶圆到卷带）、IGBT KGD（已知良好芯片）分选机；</p> <p>(2) 光通信和半导体设备提供商——苏州猎奇智能设备股份有限公司，公司主要产品为固晶机、耦合设备、测试设备等光通信和半导体设备；</p> <p>(3) 芯片动态老化测试设备以及解决方案的提供商——芯诣电子科技（苏州）有限公司，公司主要产品为动态逻辑老化测试一体机、PXI 板卡及小型化仪表等动态老化测试设备；</p> <p>(4) 芯片贴片机及相关服务提供商——鑫益邦半导体（江苏）有限公司，公司主要产品为超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机；</p> <p>(5) 射频测试仪器、射频测试机及板卡、云平台提供商——瑞玛思特（深圳）科技有限公司，公司主要产品为射频测试仪器、射频测试机及板卡及相关云平台。</p> <p>6、问：2025 年上半年各系列产品占比情况如何？</p> <p>答：受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年上半年实现营业收入 3.07 亿元，较上年同期增长 67.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,600.55 万元，较上年同期增长 91.56%。2025 年上半年，EXCEED-9000 系列产品（EXCEED-9800 系列、EXCEED-9032 系列）设备销售收入比重进一步提升至 51.37%，2024 年为 25.80%。</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025 年 10 月 10 日